

杭州士兰微电子股份有限公司

2023 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本期业绩预告适用情形：净利润为负值
- 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,200 万元到-3,500 万元，与上年同期相比，将出现亏损。本期业绩出现亏损的主要原因系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌，导致其公允价值变动产生税后净收益-45,227 万元。
- 公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 6,500 万元到 8,500 万元，与上年同期相比，将减少 54,626 万元到 56,626 万元，同比减少 87%到 90%。

一、 本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

- 1、经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,200 万元到-3,500 万元，与上年同期相比，将出现亏损。
- 2、预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 6,500 万元到 8,500 万元，与上年同期相比，将减少 54,626 万元到 56,626 万元，同比减少 87%到 90%。

（三）本期预计业绩未经注册会计师审计。

二、 上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：105,242 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：63,126 万元。

(二) 每股收益：0.74 元。

三、本期业绩变动的主要原因

1、报告期内，公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌，导致其公允价值变动产生的税后净收益为-45,227 万元。

2、报告期内，下游普通消费电子市场景气度相对较低，造成公司部分消费类产品出货量明显减少、其价格也有一定幅度的回落，对公司的销售和利润增长造成一定压力。对此，公司加大了模拟电路、IGBT 器件、IPM 智能功率模块、PIM 功率模块、碳化硅功率模块、超结 MOSFET 器件、MCU 电路、化合物芯片和器件等产品在大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度，公司总体营收较去年同期增长约 13%。

3、报告期内，公司对参股公司士兰明镓完成增资，取得士兰明镓控制权，将士兰明镓纳入合并报表范围，因合并产生投资收益 29,461 万元；同时，公司当期确认对士兰明镓的投资收益-9,694 万元，两者合计影响损益 19,767 万元。

4、报告期内，受 LED 芯片市场价格竞争加剧的影响，公司 LED 芯片价格较去年年末下降 10%-15%，导致控股子公司士兰明芯经营性亏损较上年度进一步扩大。

5、报告期内，公司持续加大对模拟电路、功率器件、功率模块、MEMS 传感器、碳化硅 MOSFET 等新产品的研发投入，加快汽车级和工业级电路和器件芯片工艺平台的建设进度，加大汽车级功率模块和新能源功率模块的研发投入，公司研发费用较去年同期增加了 22%左右。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计。公司基于自身专业判断进行初步测算，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年1月31日